第 37 回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム 2025 年 11 月 14 日

今惧· 宙北大学	環境科学研究科総合研究棟	大講盖字
五物, 宋儿八十	・ 水・元 イイナー ツーフレイイ小心 ローツーフレイネー 。	

13:00~13:40 「半導体製造におけるスマート化の目的と今後の課題」

Rapidus 株式会社

赤堀 浩史

13:40~14:20 「半導体基板洗浄装置の歴史とイノベーション」

株式会社 SCREEN ホールディングス

荒木 浩之

14:20~15:00 「先端半導体デバイスを支える薄膜形成技術」

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

廣瀬 義朗

15:00~15:20 休憩

15:20~16:00 「半導体デバイスの進化を担う常温・低温接合技術」

東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻

日暮 栄治

16:00~16:40 「革新的イメージセンサ・計測技術を基盤とした先進半導体集積回路製造技術」

東北大学 未来科学技術共同研究センター

東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻

黒田 理人

The 37th International Microelectronics Conference Program

Nov.14, 2025

Venue: Main Building, Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University

13:00~13:40 "Future Perspectives and Challenges of Smart Manufacturing in Semiconductor Production"

Rapidus Corporation

Hiroshi Akahori

13:40~14:20 "History and Innovation of Semiconductor Cleaning Equipment"

SCREEN Holdings Co., Ltd.

Hiroyuki Araki

14:20~15:00 "Thin film deposition technology for advanced semiconductor devices"

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION

Yoshiro Hirose

15:00~15:20 Break

15:20~16:00 "Room-temperature and low-temperature bonding technologies driving the evolution of Semiconductor devices"

Department of Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Tohoku University Eiji Higurashi

16:00~16:40 "Advanced semiconductor integrated circuit manufacturing technologies based on innovative image sensors and metrology"

New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University Department of Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Tohoku University Rihito Kuroda